|  |
| --- |
| **技術邀稿** |
| **技術發明者-個人基本資料** |
| **姓名** |  |
| **Name** |  |
| **電話** |  |
| **傳真** |  |
| **信箱** |  |
| **網站** |  |
| **地址****(研究室/學校)** |  |
| **Address** |  |
| **任職單位** |  |
| **Position** |  |
| **職稱** |  |
| **Title** |  |
| **專長(3-5項)** |  |
| **Expertise****(3-5 items)** |  |
| **獲獎(3-5項)** |  |
| **Award****(3-5 items)** |  |
| **個人照片** | **(請另附解析度300dpi照片)** |

聯絡資訊:專利技轉組葉小姐或黃小姐；校內分機558#21、20；Email:jmine3388@nchu.edu.tw 、 yenling@nchu.edu.tw

|  |
| --- |
| **發明者技術亮點一** |
| **技術名稱** |  |
| **Technology Name** |  |
| **中文摘要****(300字內)** |  |
| **Abstract****(英文摘要)****(250單字內)** |  |
| **關鍵字****(中文關鍵字3-5項)** |  |
| **Keywords****(英文關鍵字3-5項)** |  |
| **應用領域****(3-5項)** |  |
| **Application Field****(3-5 items)** |  |
| **技術狀態****State of Technology** | □ 已獲得專利証書□ 申請中 |
| **專利字號/申請號****Patent no. /application no.** |  |
| **申請專利國家** |  |
| **Patent Application Country** |  |
| **技術成熟度****Technology Readiness Level** | □ Level 1 創意發現□ Level 2 構想產生□ Level 3 構想驗證□ Level 4 基礎技術□ Level 5 技術整合□ Level 6 原型製作□ Level7 應用測試□ Level8 系統驗證□ Level9 技術成熟  |
| **媒合類型****Type of Technology Matching** | □ 專屬授權 Exclusive Licensing□ 非專屬授權 Non-Exclusive Licensing□ 產學合作 Industry-university cooperation□ 通路配合 Selling Channel Seeking□ 其他 Other：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(勾選此項者請填內容)  |
| **代表圖****Representative Figure****(2-6張,需註記中英文圖名)** | **(請另附解析度300dpi原始圖檔，png透明底圖為佳)** |

|  |
| --- |
| **發明者技術亮點二** |
| **技術名稱** |  |
| **Technology Name** |  |
| **中文摘要****(300字內)** |  |
| **Abstract****(英文摘要)****(250單字內)** |  |
| **關鍵字****(中文關鍵字3-5項)** |  |
| **Keywords****(英文關鍵字3-5項)** |  |
| **應用領域****(3-5項)** |  |
| **Application Field (應用領域3-5項)** |  |
| **技術狀態****State of Technology** | □ 已獲得專利証書□ 申請中 |
| **專利字號/申請號****Patent no. /application no.** |  |
| **申請專利國家** |  |
| **Patent Application Country** |  |
| **技術成熟度****Technology Readiness Level** | □ Level 1 創意發現□ Level 2 構想產生□ Level 3 構想驗證□ Level 4 基礎技術□ Level 5 技術整合□ Level 6 原型製作□ Level7 應用測試□ Level8 系統驗證□ Level9 技術成熟  |
| **媒合類型****Type of Technology Matching** | □ 專屬授權 Exclusive Licensing□ 非專屬授權 Non-Exclusive Licensing□ 產學合作 Industry-university cooperation□ 通路配合 Selling Channel Seeking□ 其他 Other：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(勾選此項者請填內容)  |
| **代表圖****Representative Figure****(2-6張,需註記中英文圖名)** | **(請另附解析度300dpi原始圖檔，png透明底圖為佳)** |

|  |
| --- |
| **發明者技術亮點三** |
| **技術名稱** |  |
| **Technology Name** |  |
| **中文摘要****(300字內)** |  |
| **Abstract****(英文摘要)****(250單字內)** |  |
| **關鍵字****(中文關鍵字3-5項)** |  |
| **Keywords****(英文關鍵字3-5項)** |  |
| **應用領域****(3-5項)** |  |
| **Application Field****(應用領域3-5項)** |  |
| **技術狀態****State of Technology** | □ 已獲得專利証書□ 申請中 |
| **專利字號/申請號****Patent no. /application no.** |  |
| **申請專利國家** |  |
| **Patent Application Country** |  |
| **技術成熟度****Technology Readiness Level** | □ Level 1 創意發現□ Level 2 構想產生□ Level 3 構想驗證□ Level 4 基礎技術□ Level 5 技術整合□ Level 6 原型製作□ Level7 應用測試□ Level8 系統驗證□ Level9 技術成熟  |
| **媒合類型****Type of Technology Matching** | □ 專屬授權 Exclusive Licensing□ 非專屬授權 Non-Exclusive Licensing□ 產學合作 Industry-university cooperation□ 通路配合 Selling Channel Seeking□ 其他 Other：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(勾選此項者請填內容)  |
| **代表圖****Representative Figure****(2-6張,需註記中英文圖名)** | **(請另附解析度300dpi原始圖檔，png透明底圖為佳)** |